

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【公開番号】特開2004-95679(P2004-95679A)

【公開日】平成16年3月25日(2004.3.25)

【年通号数】公開・登録公報2004-012

【出願番号】特願2002-251959(P2002-251959)

【国際特許分類第7版】

H 05 K 3/34

H 01 L 23/12

H 01 P 5/08

H 05 K 1/02

H 05 K 1/18

【F I】

H 05 K 3/34 5 0 1 D

H 01 L 23/12 3 0 1 Z

H 01 P 5/08 L

H 05 K 1/02 J

H 05 K 1/18 J

【手続補正書】

【提出日】平成17年8月19日(2005.8.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

信号ラインが形成された誘電体基板上に部品を実装する部品実装方法において、

前記信号ラインの形状と前記部品に設けられた電極の形状とを整合させる整合用導体を、前記信号ライン上に実装する段階と、

前記部品を前記整合用導体上に実装し、前記信号ラインと前記部品に設けられた電極とを前記整合用導体を介して電気的に接続する段階とを有することを特徴とする部品実装方法。

【請求項2】

信号ラインが形成された誘電体基板と、その誘電体基板上に実装された部品とを有する電子回路において、

前記信号ライン上に実装されており、前記信号ラインの形状と前記部品に設けられた電極の形状とを整合させる整合用導体と、

前記整合用導体上に実装されており、前記電極が前記信号ラインに前記整合用導体を介して電気的に接続された部品とを有することを特徴とする電子回路。

【請求項3】

前記整合用導体は、前記部品に対向する接触面の幅が前記信号ラインに対向する接触面の幅よりも大きく、前記部品に対向する接触面の幅と、前記信号ラインに対向する接触面の幅と、前記誘電体基板の厚みと、前記整合用導体の幅が前記部品に対向する接触面の幅と同じになる高さと前記誘電体基板との間隔とに応じて、前記信号ラインと前記部品との特性インピーダンスを整合させることを特徴とする請求項2記載の電子回路。

**【手続補正2】****【補正対象書類名】**明細書**【補正対象項目名】**0002**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【0002】****【従来の技術】**

例えば光通信装置は、マイクロ波又はミリ波などの高周波領域の信号を扱う電子回路（以下、単に電子回路という）を含むように構成されている。このような電子回路は、数 kHz～数十GHz程度の広帯域特性が必要であった。

したがって、電子回路の誘電体基板上に実装する部品は、良好な広帯域特性が要求されていた。例えば特開平4-278571号公報、特開2000-269383号公報、特開2001-144395号公報、特開平9-107210号公報および特開平4-67657号公報には、誘電体基板上に実装した部品の広帯域特性を良くする技術が記載されている。